



自動車・鉄道・船舶

家電・エレクトロニクス

航空・宇宙・海洋

環境・エネルギー

最新実装技術でエレクトロニクス製品の“超小型化”を開発から量産までワンストップサポートいたします。

得意技術

半導体ベアチップ実装技術をコアにファインデバイス実装技術、各種センサの小型パッケージング技術、次世代パワーモジュールの小型化技術などを保有

- ・半導体ベアチップのバンブ形成、フリップチップ実装、ワイヤボンディング、特殊モールド技術
- ・CMOS センサ、MEMS センサ、磁気センサ等のパッケージング技術
- ・SiC 等の次世代パワーモジュール技術

主要事業・主要製品

主要事業：各種半導体実装モジュールの開発・試作・製造

主要製品

- ・半導体実装及び高密度 SMT 実装の受託製造
- ・各種小型センサパッケージ（CMOS イメージセンサ、分光センサ、MEMS センサ等）
- ・各種パワーモジュール（小型 SiC パワーモジュール、両面放熱型パワーカード等）
- ・光通信モジュール、高輝度 LED モジュール、高周波モジュール、RFID モジュール 等



得意な顧客・市場分野

得意な顧客：エレクトロニクスメーカー、子部品メーカー、半導体メーカー、材料メーカー

市場分野：エレクトロニクス分野（センサ P K G、各種回路基板モジュール）

- ・車載機器分野（カメラ、パワーモジュール）、環境・エネルギー分野（電力変換モジュール）
- ・医療機器分野（センサモジュール）

今後の展開について

次世代半導体実装技術、光学実装技術を開発し、センサ事業及びパワーモジュール事業の拡大

グローバルビジネス

- ・センサモジュール及びパワーモジュールを中心に海外販売展開
- ・中長期的には現地生産も視野に入れ、海外部品材料の調達、海外生産を検討

公的助成事業 受託

平成 23 年度グリーン IT 活用産業振興事業

平成 25 年度エネルギー関連ベンチャー事業化促進事業

平成 25 年～平成 26 年 かながわ成長産業イノベーション事業

平成 25 年～平成 26 年 横浜市中心企業新技術・新製品開発促進助成金

平成 27 年～平成 28 年 平成 26 年度補正 ものづくり・商業・サービス革新補助金

取得資格・認証 (ISO 等)

平成 26 年 11 月 ISO9001 取得、平成 28 年横浜知財みらい企業認定（平成 24 ～認定企業）

主要設備・研究体制

- ・主要設備：フリップチップボンダ、ダイボンダ、各種ワイヤボンダ、トランスファモールド装置、真空ギ酸リフロー装置、プラズマドライ洗浄装置、BGA ボールマウンター、SMT ライン、2D&3D プレス装置、超音波探傷解析装置、サブミクロンフォーカス X 線装置、FE-SEM、レーザー顕微鏡、パワーメーター等、クリーンルーム クラス 100 ～ 1000
- ・研究体制：横浜国立大学 K AMOME プロジェクト、神奈川科学技術アカデミー、神奈川産業技術センター等、大学・研究機関の協力を得て先端技術の開発取組をしています。

主要取引先

コニカミノルタ（株）、ソニー（株）、（株）アドバンテスト、パナソニック（株）、（株）日立製作所、（株）フジクラ、オリパス（株）等

名称	マイクロモジュールテクノロジーカブシキガイシャ マイクロモジュールテクノロジー株式会社	代表者	原園 文一	担当窓口	宮村 南	資本金	1,200 万円	従業員数	27 名
所在地	〒 230-0045 横浜市鶴見区末広町 1-1-40 横浜市産学共同研究センター 201 号室			TEL	045-510-3080	FAX	045-510-3081		
HP	http://www.micro-module.co.jp			E-mail	m.miyamura@micro-module.co.jp				